



DDR5 行业跟踪报告之一：AMD 新款数据中心 CPU “GENOA” 发布在即 服务器 DDR5 有望加 速渗透



AMD Zen4 EPYC 发布在即。AMD 官方公告，宣布将于太平洋时间 2022 年 11 月 10 日举办名为 “together we advance datacenters” 的直播活动，推出代号为 “Genoa” 的下一代 EPYC（霄龙）数据中心 CPU。AMD 的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场，详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。

内存模组行业：DDR5 持续渗透，AMD 有望加速数据中心 CPU 领域的 DDR5 渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径，JEDEC 组织定义内存模组的组成构件、性能指标、具体参数等，2021 年 DDR5 第一子代相关产品已开始量产，内存模组正在从 DDR4 世代开始向 DDR5 世代切换，同时 JEDEC 正在制定 DDR5 第二子代、第三子代产品标准。内存模组与 CPU 是计算机的两个核心部件，是计算机生态系统的重要组成部分，INTEL 和 AMD 支持新一代内存模组的 CPU 上市将推动内存模组的更新换代。支持 DDR5 的主流桌面级 CPU 已于 2021 年正式发布，普通台式机/笔记本电脑 DDR5 内存模组逐渐上量；未来随着支持 DDR5 的主流服务器 CPU 规模出货，DDR5 服务器内存模组渗透率将持续提升。

DDR5 内存技术正在逐步实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 第一子代内存接口芯片相比于 DDR4 最后一个子代的内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。从 JEDEC 已经公布的相关信息来看，DDR5 内存接口芯片已经规划了三个子代，支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s，预计后

续可能还会有 1~2 个子代，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

INTEL 未来将进一步推升 DDR5 在 PCNB 和服务器市场中的渗透率。INTEL 支持 DDR5 的两大系列 CPU 已陆续步入放量期，DDR5 渗透率持续加速，其中面向 PCNB 领域的 AlderLakeCPU 已于 2021 年发布，INTEL 预计面向数据中心领域的 SapphireRapids 将于 2022~2023 年量产出货。

澜起科技：DDR5 世代市场份额持续稳定。澜起科技的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。市场份额方面，公司在 DDR4 世代逐步确立了行业领先优势，是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一，占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代，公司继续领跑，内存接口芯片的市场份额保持稳定。

公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47871

